

組織委員会

委員長：加柴 良裕（大阪大学）
副委員長：青柳 昌宏（国研産業技術総合研究所）
岩本 知広（茨城大学）

委員：
瀧美幸一郎（大阪大学）、荒井 栄司（大阪大学）、大熊 秀雄（(有)エイチ・ティー・オー）、小勝 俊巨（NECソリューションイノベータ(株)）、久保 雅男（パナソニック(株)）、河野 英一（(株)河野エムイー研究所）、小林紘二郎（(一財)電子科学研究所）、齋藤 重正（(株)GYシステムズ）、嶋田 勇三（ナミックス(株)）、菅沼 克昭（大阪大学）、清野 武寿（(株)東芝）、高橋 康夫（大阪大学）、高橋 良和（東北大学）、高山 智生（三菱電機(株)）、武井 利泰（(株)ジャパノニックス）、竹本 正（大阪大学）、田中 敏宏（大阪大学）、津久井 勤（リサーチラボ・ツクイ）、寺前 俊哉（(株)日立製作所）、西田 一人（パナソニック(株)）、貫井 孝（京都大学）、廣瀬 明夫（大阪大学）、藤本 公三（大阪大学）、松村 慶一（インフイテックエム(株)）、南 二三吉（大阪大学）、南尾 匡紀（パナソニック(株)）、宮崎 則幸（佐賀大学）、村井 淳一（三菱電機(株)）、矢野 映（(株)富士通研究所）、山本 治彦（富士通ICT(株)）、吉田 隆（富士電機(株)）

実行委員会

委員長：福本 信次（大阪大学）
副委員長：荘司 郁夫（群馬大学）
佐野 智一（大阪大学）

委員：
朝倉 義裕（神戸市立工業高等専門学校）、新井 進（信州大学）、安藤 哲也（室蘭工業大学）、池田 徹（鹿児島大学）、石橋 正朗（凸版印刷(株)）、出田 吾朗（三菱電機(株)）、井上 雅博（群馬大学）、岩田 剛治（大阪大学）、上西 啓介（大阪大学）、上村 泰紀（(株)富士通研究所）、海老原伸明（NECスペーステクノロジー(株)）、岡本 康寛（岡山大学）、小川 泰史（ソマル(株)）、小椋 智（大阪大学）、折井 靖光（長瀬産業(株)）、梶原 隆志（エスバック(株)）、鎌田 信雄（化研テック(株)）、苅谷 義治（芝浦工業大学）、木村 文信（東京大学）、木村 裕二（(株)村田製作所）、高齋 光弘（千住金属工業(株)）、小林 竜也（群馬大学）、小山 真司（群馬大学）、阪元 智朗（オムロン(株)）、作山 誠樹（(株)富士通研究所）、佐藤 強（(株)東芝）、佐名川佳治（パナソニック(株)）、関本 隆司（日本アピオニクス(株)）、高尾 尚史（(株)豊田中央研究所）、高岡 英清（(株)村田製作所）、高橋 邦夫（東京工業大学）、富岡 泰造（(株)東芝）、西浦 正孝（大阪大学）、西川 宏（大阪大学）、久田 隆史（日本アイ・ピー・エム(株)）、平井 維彦（(株)ケーヒン）、藤野 純司（三菱電機(株)）、藤原 伸一（(株)日立製作所）、松岡 洋（日本電気(株)）、松坂 壮太（千葉大学）、松嶋 道也（大阪大学）、園尾 弘樹（パナソニック(株)）、水野 潤（早稲田大学）、満倉 一行（日立化成(株)）、見山 克己（北海道科学大学）、村山 啓（新光電気工業(株)）、森 三樹（東京大学）、森 貴裕（(株)ADEKA）、両角 朗（富士電機(株)）、安田 清和（大阪大学）、山内 啓（群馬工業高等専門学校）、山口 敦史（パナソニック(株)）、山中 公博（中京大学）、山根 常幸（(株)東レリサーチセンター）、山部 光治（(株)東芝）、山本 哲也（(株)東芝）、山本 佑樹（(株)弘輝）、横沢 伊裕（NEDO）、渡邊 聡（藤倉化成(株)）、渡辺 潤（長野沖電気(株)）、渡邊 裕彦（富士電機(株)）

（依頼中を含む）

＜問合せ先＞
（一社）スマートプロセス学会
エレクトロニクス生産科学部会 事務局
＜ものづくりリエゾンオフィス（MLO）＞

E-MAIL：mate@sps-mste.jp
PHONE：06-6879-7568 FAX：06-6879-7568

First Circular and Call for Papers 論文募集

Mate 2021

27th Symposium on
“Microjoining and Assembly Technology in Electronics”
2-15 Feb. 2021

第27回 「エレクトロニクスにおけるマイクロ 接合・実装技術」シンポジウム

開催期間：2021年2月2日(火)～15日(月)
開催方式：オンライン
（最新情報は、シンポジウムHPにてご案内致します）

主催：
（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
（一社）溶接学会 マイクロ接合研究委員会

共催：
（一社）エレクトロニクス実装学会
（公社）化学工学会 エレクトロニクス部会
（一社）レーザ加工学会

協賛：
応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、
日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会

（依頼中を含む）

開催主旨

日本のエレクトロニクス産業は、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の成長を牽引してきました。さらに今後、IoTやAIを活用した未来社会を実現していくためには、生産技術の科学的探求をベースとしつつ、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。



オンライン方式

Mate2021は、新型コロナウイルス感染防止のため、オンライン方式での開催になりました。場所や時間の制約もなく、2週間にわたり、いつでも、どこからでも、何度でも自由に聴講できます。奮って、お申込みください。

論文募集

開催主旨に従い、シンポジウムを開催いたします。つきまして、独創性に富むオリジナル論文（学術論文、研究開発論文）を募集しております。各講演の発表時間は12分程度を予定しております。投稿希望の方はWEB申込みしていただくようお願い申し上げます。執筆要項、学術論文、研究開発論文の区分等に関しましては、申込者への通知送付時に投稿規定とともに送付させていただきます。

速報論文募集

最新のデータを公表できる場として、オリジナル速報論文を新設します。2ページの速報論文で申込みが可能です。各講演の発表時間は8分程度を予定しております。投稿希望の方はWEB申込時に速報論文を選択していただくようお願い申し上げます。

表彰

本シンポジウムで発表された優秀なオリジナル論文に対してシンポジウム賞（優秀論文賞、奨励賞）、また速報論文および学生の発表に対して表彰制度を用意しております。

申込方法

下記URLに申込みホームページを設けますので、必要事項を記入して申込みを行ってください。

<http://sps-mste.jp/mate/>

申込締切：2020年9月7日（月）

概要受理決定後、論文発表の場合は4ページ～6ページの論文を提出、また速報論文の場合は2ページの論文を提出してください。なお、論文投稿の流れや論文執筆要項などの詳細はホームページを参照してください。

論文提出締切：2020年11月13日（金）
速報論文提出締切：2020年11月24日（火）

参加費 *税込み

主催団体個人会員	: 12,000円
主催団体シニア会員	: 5,000円
大学・国公立研究機関	: 12,000円
口頭発表者・座長	: 10,000円
主催団体維持・賛助会員	: 15,000円
共催団体会員	: 17,000円
協賛団体会員	: 20,000円
一般	: 22,000円
学生	: 3,000円

カテゴリーA 工 法

- A-1 固相接合
- A-2 ソルダリング
- A-3 ろう付
- A-4 溶接
- A-5 接着
- A-6 ナノプロセッシング
- A-7 成膜
- A-8 印刷
- A-9 ビーム加工
- A-10 エッチング
- A-11 マイクロ加工
- A-12 塑性加工
- A-13 システム化・統合化
- A-14 その他

カテゴリーB 研究・開発の観点

- B-1 金属材料
- B-2 有機材料
- B-3 複合材料
- B-4 加工プロセス
- B-5 アセンブリプロセス
- B-6 メカニズム・現象解析
- B-7 接合・界面構造
- B-8 信頼性
- B-9 解析・シミュレーション
- B-10 機能設計・システム
- B-11 熱マネジメント
- B-12 設備・機器
- B-13 検査・評価
- B-14 計測・分析
- B-15 生産システム
- B-16 その他

カテゴリーC 対象形態・製品

- C-1 デバイス
- C-2 パッケージ（3D, ウェハレベル等）
- C-3 モジュール（パワー）
- C-4 モジュール（車載, 光, LED等）
- C-5 MEMS・センサー
- C-6 実装部品
- C-7 基板（PCB, インターポーザ等）
- C-8 エネルギー変換機器
- C-9 車載機器
- C-10 通信・携帯機器, コンピュータ
- C-11 光学・表示機器
- C-12 医療・ハイオ機器
- C-13 航空宇宙機器
- C-14 その他